Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M580, moduł procesora, poziom 3

BMEP583040

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon M580
Typ produktu lub komponentu	Moduł procesora

Parametry uzupełniające

liczba racków	8
Local I/O processor capacity (discrete)	3072 WE/WY
Local I/O processor capacity (analog)	768 WE/WY
Number of application specific channel (local rack)	108
specyficzne WE/Wy aplikacji	Połączenie szeregowe Sterowanie ruchem Licznik Enkoder SSI HART Dokładne datowanie
Diagnostyka pamięci	Sterowanie procesem
kanały sterowania	Pętle programowalne
połączenie typu zintegrowanego	1 Ethernet TCP/IP dla port usługowy 2 Ethernet TCP/IP dla sieć urządzeń Port USB typ mini B
liczba zdalnych stanowisk we/wy	16 - 2 stojak(i) na odpływ daleki
liczba rozmieszczonych urządzeń	64
procesor modułu komunikacyjnego	16 moduł interfejsu AS 3 moduł komunikacji Ethernet
obsługa komunikacji	Skaner RIO Skaner DIO
opis pamięci	Nadający się do rozbudowy Flash, 4 GB dla przechowywanie danych Zintegrowany RAM, 10 kB dla pamięć systemu Zintegrowany RAM, 12 MB dla program Zintegrowany RAM, 1024kB dla dane
struktura aplikacji	2 zadania pomocnicze 1 cykliczne/okresowe zadanie główne 128 zdarzeniowe zadania 1 okresowe szybkie zadanie

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Cyberbezpieczeństwo	Achilles certified DoS prevention IPSec SNMP logging Syslog protocol support Transport layer security Audit trail Embedded firewall Firmware signature Password protection Port hardening Secure communication (HTTPS) Security log
liczba rozkazów na ms	30 Kinst/ms 65 % Boole'owska + 35 % ustalona arytmetyka 40 Kinst/ms 100 % Boole'owski
obciążenie prądowe	295 mA w 24 V DC
średni czas między awariami (MTBF)	775000 H
Oznakowanie	CE

Środowisko pracy

Odporność na wibracje	3 gn
Odporność na wstrząsy	30 gn
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…85 °C
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m 2000...5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych
wilgotność względna	5…95 % w 55 °C bez kondensacji
Stopień ochrony IP	IP20
wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
certyfikacja produktu	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy
Normy	IEC 61131-2 IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G
odporność na czynniki środowiskowe	Lokalizacja niebezpieczna klasa I div. 2
zasilanie	Zasilacz wewnętrzny na stojak
lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) praca procesora (RUN) 1 lampka LED (Czerwony) procesor lub awaria systemu (ERR) 1 lampka LED (Czerwony) błąd modułu WE/WY 1 lampka LED (zielony) trwa pobieranie (DL) 1 lampka LED (Czerwony) błąd karty pamięci lub CPU (BACKUP) 1 lampka LED (zielony/czerwony) ETH MS (status konfiguracji portu Ethernet) 1 lampka LED (zielony/czerwony) Eth NS (stan sieci Ethernet)
Masa produktu	0,849 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,500 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	25,000 cm
Waga opakowania 1	875,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,640 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Emisja dwutlenku węgla (kg CO2 eq.)	**245**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie z tekturą pochodzącą z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**4eb70ab0-978b-4773-a441-0cc20d6144a1**
Chińskie rozporządzenie RoHS	**Dyrektywa RoHS Chiny**

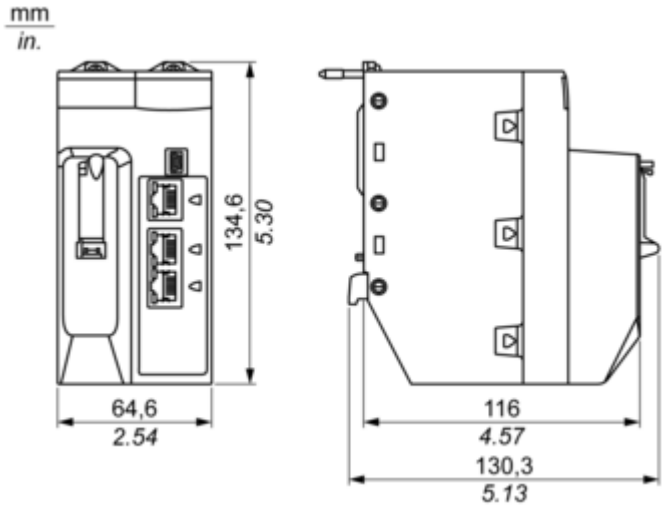
Use Again

Przepakowanie i regeneracja

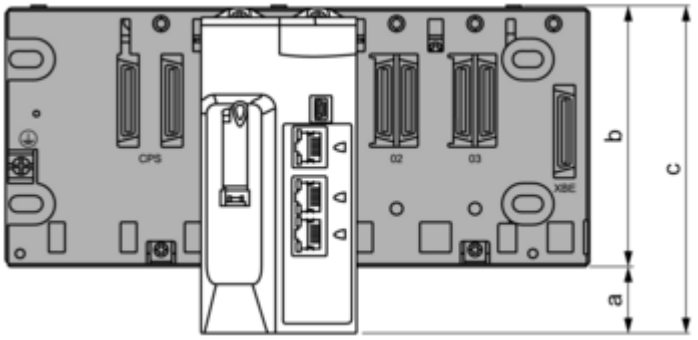
Profil cyklu życia produktu (PEP)	**Informacja o żywotności**
WEEE	**Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.**
Odbiór produktów	**No**

Dimensions Drawings

CPU Module Only

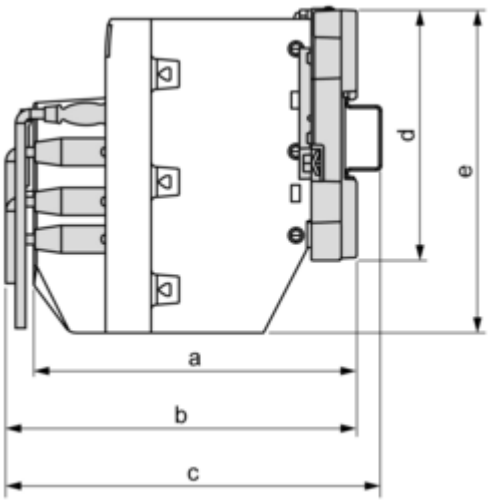


Modules Mounted on Racks



a: additional space below the rack to accommodate the height of the CPU. For an X Bus rack, the value is 30.9 mm (1.217 in.); for an Ethernet rack, the value is 29.49 mm (1.161 in.).
b: the height of the rack. For an X Bus rack, the height is 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, the height is 105.11 mm (4.138 in.).
c: the height of the main local rack, 134.6 mm (5.299 in.)

Modules and Cables Mounted in an Enclosure



a: enclosure depth: 135 mm (5.315 in.)
b: wiring + module depth: > 146 mm (5.748 in.)
c: wiring + module + DIN rail depth: > 156 mm (6.142 in.)
d: rack height: for an X Bus rack 103.7 mm (4.083 in.); for an Ethernet rack, 105.11 mm (4.138 in.)
e: module height: 134.6 mm (5.299 in.)